

Embalaje y etiquetado en las próximas ferias de EasyFairs®



La tercera edición de EasyFairs® Packaging Innovations Barcelona 2010, el Salón Internacional de Tendencias en Packaging de Alto Valor Añadido, tendrá lugar en el CCIB-Recinto del Fórum de Barcelona los días 14 y 15 de abril. En esta ocasión, se celebrará paralelamente con EasyFairs® Labelling Innovations Barcelona 2010, el Salón Internacional del Etiquetado, Codificación, Trazabilidad e Impresión del sur de Europa.

Más de 150 expositores, al menos un 20% de ellos internacionales, mostrarán los últimos avances en diseño gráfico e industrial, *branding* y gestión de marca, transformación de materiales, ecopackaging, PLV, embalaje publicitario y promocional, servicios de impresión y packaging inteligente, en el caso de easyFairs® Packaging Innovations. En el salón de easyFairs® Labelling Innovations, se presentarán las novedades en etiquetado, tecnología de preimpresión y producción, codificación, trazabilidad, procesos y maquinaria de impresión, nuevos materiales, RFID, soluciones de seguridad y adhesivos y tintas.

Interesantes novedades

La próxima edición del Salón EasyFairs® Packaging Innovations Barcelona presentará numerosas novedades. No solo por parte de los expositores, sino también por la inclusión de nuevas áreas con identidad propia. La primera es la denominada Zona Design in Italy, en la que se mostrará las novedades en exclusiva de diseñadores de packaging de toda Italia. La segunda es el Área World Design, un espacio de inspiración donde descubrir ideas de todos los rincones del mundo. Además, durante el salón se presentará el Informe de Tendencias del Packaging de Diseño, realizado por easyFairs®. ■

www.easyfairs.com